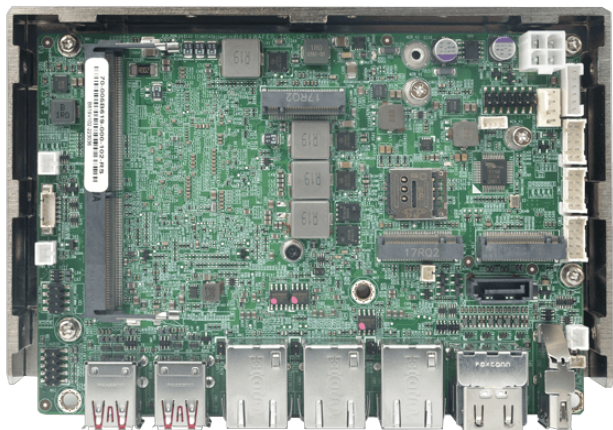


WAFER-TGL-U

3.5寸 SBC 支持 Intel® Tiger Lake-UP3 Core I™ Celeron® 处理器，支持 HDMI™, DP, iDPM, 三个 2.5 GbE 网口, USB 3.2, M.2, SATA 6Gb/s, COM, Audio, 符合RoHS, -20°C ~60°C



Features

1. 3.5寸SBC搭配 Intel® Tiger Lake-UP3 板载 SOC 处理器，支持 SO-DIMM DDR4-3200 内存
2. 支持四重独显：2 x HDMI™ 1.4, 1 x DP 1.4, 1 x iDPM
3. 高速 I/O 接口：4 x USB 3.2 gen 2 (10Gb/s)、SATA (6Gb/s)
4. 支持三路 Intel® I225V 2.5GbE 网口
5. 支持 M.2 A Key, B key 扩展

Specifications

系统	
CPU	第 11 代 Intel® 移动 Tiger Lake-UP3 板载处理器
	Intel® Core™ i7-1185G7E (高达4.4GHz,四核, 12M 缓存, TDP=28/15/12W)
	Intel® Core™ i5-1145G7E (高达4.1GHz, 四核, 8M 缓存, TDP=28/15/12W)
	Intel® Core™ i3-1115G4E (高达3.9GHz,双核, 6M 缓存, TDP=28/15/12W)
	Intel® Celeron® 6305E (高达1.8GHz,双核,4M 缓存, TDP=15W)
内存	1 x 260-pin 3200 MHz DDR4 SO-DIMMs, 支持多达 32 GB
内存上限	支持多达至 32GB
散热方案/系统风扇	1 x 系统风扇接口 (1x4 pin, P=2.54)
存储	
存储	1 x SATA : 6Gb/s 带5V SATA 电源连接器
	1 x M.2(NGFF) : B Key(2242/3052) with PCIe Gen3 x2,support NVME storage
I/O 接口	
显示输出	2 x HDMI™ : 高达4096 x 2160@30Hz
	1 x Display Port : 高达4096 x 2160@60Hz
	1 x iDPM : IEI iDPM 3040 槽位 (仅支持IEI eDP/LVDS/VGA模块)
网络	3 x LAN -
	LAN1: Intel® I225V 2.5GbE 控制器
	LAN2: Intel® I225V 2.5GbE 控制器
	LAN3: Intel® I225V 2.5GbE 控制器
音频	1 x HD Audio : 1 x iAUDIO, 支持 IEI AC-KIT-888S 音频组件 (2x5 pin)
I/O接口	1 x 内部RS-232 : 2x5 pin, P=2.0
	2 x 内部RS-232/422/485 : 2x5 pin, P=2.00 ,RS-485 支持 AFC
	2 x 内部 USB 2.0 : 2x4 pin, P=2.00
	1 x DIO : 12位数字 I/O (2x7 pin, P=2.0)
	4 x 外部 USB 3.2 Gen2x1 : 10Gb/s
扩展	2 x M.2(NGFF) -
	1 x M.2 A key (2230)基于PCIe Gen3 x1/USB 2.0信号
	1 x M.2 B Key (2242/3052)基于PCIe Gen3 x2/USB 2.0信号用于5G模块
Other Features	
TPM	Intel® PTT(TPM 2.0)
电源	
电源供电	+12V直流电压输入(AT/ATX模式)

环境	
操作温度	0°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ 70°C
Humidity	5% ~ 95%, 无冷凝
认证	
Safety & EMC	符合CE/FCC

Ordering Information

WAFER-TGL-U-i7-R11	3.5" SBC with Intel® Tiger Lake-UP3 Core™ i7-1185G7E Processor,DDR4 SO-DIMM,12V DC input,Quad Display,Triple M.2 with A/B key,Triple Intel® 2.5 GbE,SATA,USB3.2,SoC,RoHS
WAFER-TGL-U-i5-R11	3.5" SBC with Intel® Tiger Lake-UP3 Core™ i5-1145G7E Processor,DDR4 SO-DIMM,12V DC input,Quad Display,Triple M.2 with A/B key,Triple Intel® 2.5 GbE,SATA,USB3.2,SoC,RoHS
WAFER-TGL-U-i3-R11	3.5" SBC with Intel® Tiger Lake-UP3 Core™ i3-1115G4E Processor,DDR4 SO-DIMM,12V DC input,Quad Display,Triple M.2 with A/B key,Triple Intel® 2.5 GbE,SATA,USB3.2,SoC,RoHS
WAFER-TGL-U-CE-R11	3.5" SBC with Intel® Tiger Lake-UP3 Celeron 6305E Processor,DDR4 SO-DIMM,12V DC input,Quad Display,Triple M.2 with A/B key,Triple Intel® 2.5 GbE,SATA,USB3.2,SoC,RoHS

Packing List

1 x WAFER-TGL-U 主板	1 x SATA 线材
1 x I/O 挡片	1 x QIG